

第25届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国-天津

ICEPT 2024 主要嘉宾

(排名不分先后)

毕克允 电子部第 13 研究所前所长
叶甜春 国际欧亚科学院院士、国家科技重大专项 02 专项专家组组长
姜 勇 天津工业大学校长
汪正平 中国工程院外籍院士、美国国家工程院院士、香港科学院院士、IEEE Fellow
过增元 中国科学院院士
刘 胜 中国科学院院士、IEEE Fellow
马莒生 IEEE Fellow、清华大学教授、东京大学 Fellow
刘建影 瑞典查尔姆斯理工大学教授、瑞典皇家工程科学院院士、IEEE Fellow
张国旗 荷兰工程院院士，IEEE Fellow、IEEE 国际宽禁带电力电子技术路线图委员会秘书长；荷兰 Delft 大学微纳电子系统集成与可靠性主任教授
John H LAU IEEE Fellow、台湾 Unimicron 公司技术专家
Tadatomo SUGA 东京大学名誉教授、明星大学教授
Kitty Pearsall IEEE EPS 前资深主席
郭一凡 易卜半导体联合创始人、IEEE Fellow
李世玮 IEEE Fellow、香港科技大学
李宁成 IEEE Fellow、中国炫纯材料公司创始人
樊学军 IEEE Fellow、美国拉马尔大学教授
Weikoh IEEE Fellow 美国 Pacrim 创始人
Andrew Tay IEEE Fellow、ASME Fellow

罗小兵 IEEE Fellow、华中科技大学能源学院院长
曹立强 中国科学院微电子研究所副所长
王启东 中国科学院微电子研究所系统封装与集成研发中心主任
梅云辉 天津工业大学科学技术研究院院长兼电气工程学院常务副院长
张建华 上海大学副校长
孙 蓉 深圳先进电子材料国际创新研究院创院院长，中科院深圳先进院材料所所长
崔成强 广东工业大学教授、佛智芯创始人
Scott CHEN 日月光工程中心资深副总
YP WANG SPIL 研发中心副总裁
侯召政 华为数字能源技术与平台规划部部长
Viorel Dragoi EV Goup 首席科学家
Gu-Sung Kim 韩国江南大学教授，电子封装研究中心创始人
Suganuma Katsuaki 日本大阪大学 F3D 实验室教授
Farhang Yazdani BroadPak Corporation CEO
沙超群 海光信息董事长
小林大士 爱发科集团先进技术研究所所长
Swen Zhu EV Group 中国区总经理
张雪松 广州汉源新材料股份有限公司总经理
王 玮 北京大学集成电路学院副院长、微米纳米加工技术全国重点实验室主任

刘志权 中国科学院深圳先进技术研究院研究员、中国科学院百人计划海外引进学者

杭 弢 上海交通大学教授，材料学院副院长，电子材料与技术研究所以所长

刘丰满 中国科学院微电子研究所教授

杨道国 桂林电子科技大学“电子信息材料与器件教育部工程研究中心”副主任、广西电子封装与组装技术工程研究中心主任

蔡 坚 清华大学教授、集成电路学院党委书记

黄明亮 大连理工大学材料科学与工程学院 院长、大连理工大学电子封装材料研究所所长

陈志文 武汉大学教授、湖北省杰青、电子制造与封装集成湖北省重点实验室副主任

张 昱 广东工业大学教授、校“青年百人计划”A类引进人才

秦 飞 第十三届全国人民代表大会代表、北京工业大学电子封装技术与可靠性研究所所长

杨晓锋 工业和信息化部电子第五研究所可靠性实验室技术总师

叶怀宇 南方科技大学教授、深圳第三代半导体研究院封装项目负责人

牛萍娟 天津工业大学电子与信息工程学院常务副院长兼党委副书记

尚金堂 东南大学教授、卓越青年科学基金获得者

肖 克 中科院上海微系统所教授

于大全 厦门大学特聘教授、厦门云天半导体董事长

田艳红 哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任、国家级高层次人才

徐冬梅 中国半导体行业协会副理事长

郑雪峰 西安电子科技大学微电子学院院长兼集成电路学部副主任

郭宇铮 武汉大学动力与机械学院副院长

张国平 深圳先进电子材料国际创新研究院副院长

陈传彤 日本大阪大学 3D 电子封装集成研究所副教授

Karsten Meier 德国德累斯顿工业大学电子封装技术研究所助理主任

王 新 杭州晶通科技有限公司首席技术官、研发副总

张 源 半导体专家级讲师

车法星 美光半导体新加坡高级技术工程师

徐思行 湖南大学副教授

张 靖 贺利氏电子中国研发总监

樊海波 安世半导体香港高级首席工程师

宁 达 肖特玻璃中国区半导体业务负责人

杨荣贵 北京大学教授

孙 鹏 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司总经理

杨秉君 爱发科集团执行役員、中国区总裁

韩 钢 爱发科（苏州）技术研究开发有限公司总经理

周雅萍 迪思科科技（中国）有限公司副总经理

朱永兵 天津海瑞电子科技有限公司总经理

范正强 天津海瑞电子科技有限公司副总经理

韩佐晏 广东天承科技股份有限公司 CTO

贺育方 广东伊帕思新材料科技有限公司总经理

黄晓娴 夸泰克(广州)新材料有限责任公司总经理

陈维恕 夸泰克（广州）新材料公司副总经理

苏德志 山东华宇航空间技术有限公司副总经理

宁效庆 浙江伟思试验设备有限公司总经理

李元雄 芜湖立德智兴半导体有限公司 CTO

张洪泽 中国电子科技集团有限公司第五十五研究所副主任

Hua Younan Wintech-Nano, VP

周 凯 上海道宜半导体 COO

Li Ma Indium corporation, Senior Research Chemis, Specialist

Jay Zhang Corning Incorporated, Business Development Director

赵 波 湖北九峰山实验室 TD 负责人/主任工程师

Yang ZHOU Archimedes Semiconductor CTO

韩佐宴 广东天承科技股份有限公司技术总监

孙小波 深圳市立特为智能有限公司/开芯有限公司总经理

徐 朴 深圳市福英达工业技术有限公司总经理

周国富 英国工业显微镜有限公司销售总监

张 伍 深圳市山木电子设备有限公司运营总监

刘云兵 芬泰电子（上海）有限公司中国区总监

谭 平 中科化新材料技术（东莞）有限公司总经理

任海忠 北京华微世纪科技有限公司副总

李金平 中国电子系统工程第二建设有限公司有限公司

任开阔 天津凯华绝缘材料股份有限公司总经理

谢贵久 北京中电科电子装备有限公司总经理

吴道伟 西安微电子技术研究所副总工艺师

罗 威 华为日本主任工程师

孔令文 安捷利美维电子（厦门）有限责任公司

汤加苗 安捷利美维电子（厦门）有限责任公司 FCBGA 产
品总经理

吕秀启 华为终端有限公司主任工程师

陈雷达 珠海天成半导体科技有限公司副总经理

郭 睿 中化银鞍资本董事总经理

张承勇 上海光键半导体设备有限公司总经理

汪 松 湖北江城芯片中试服务有限公司副总经理

JONGHYUN CHAE HONOR 高级技术专家

曹 权 武汉飞思灵微电子技术有限公司相干光首席专家

李光耀 深圳市中兴微电子部长

贾 斌 明士新材料有限公司总经理

钟建华 北京信息科学技术研究院副所长

刘 伽 重庆启迪高开科技园运营管理有限公司总经理

唐宏浩 比亚迪汽车工业有限公司主任功率工程师

陆南平 无锡创达新材料股份有限公司副董事长

何荣基 卫利国际科贸(上海)有限公司董事长

何建锡 江苏元夫半导体科技有限公司先导集团 VP

姜 林 北京北方华创微电子装备有限公司业务发展二部总经理

Minglu XIA Hong Kong Applied Science and Technology
Research Institute Company Limited Principal Engineer

李彦斌 武汉帝尔激光科技股份有限公司销售副总裁

ARATA.TAKANORI 杰希优(深圳)贸易有限公司总经理

甘志华 北京七星华创微电子有限责任公司工艺总师

霍 炎 矽磐微电子重庆有限公司厂长

何洪文 沛顿科技 CTO

曹 瑞 中国空间技术研究院副主任设计师

王宁宁 北京卫星制造厂有限公司主任

杨 程 长电科技科学家

廖原原 中国电子系统工程第二建设有限公司设计院长

陈 思 紫光展锐(上海)科技有限公司封装系统架构部负责人

姚 力 紫光展锐(上海)科技有限公司封装设计工程部部长

史洪宾 先导科技集团高级总监

张雪灵 深圳市聚峰锡制品有限公司 COO

黄会然 拓鼎电子科技有限公司总经理

王瑞霞 天津市集成电路行业协会常务副秘书长

贾照伟 盛美半导体设备（上海）股份有限公司工艺副总

沈 超 上海华为技术有限公司主任工程师

胡 杏 湖北三维半导体集成创新中心

沈 凡 昆山弗莱吉电子科技有限公司